## Customer:

No. SW065017A

Date: 2006- 07- 20

ALPS EUROPE DISTRIBUTION

Attention:

Your ref. No.:

Your Part No.: SSSS222700

## SPECIFICATION

ALPS';

MODEL:

**STSSS2221** 

Spec. No.: \$\$\$\$2-\$-802

Sample No.: F3290871M

RECEIPT STATUS

RECEIVED

By Date

Signature

Name

Title

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

K.
DSG' D Tomita

APP'D K.ITO

Sales

Head Office 1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo. 145-8501 Japan Phone. +81(3)3726-1211

	_			,,			
		MENT No. 3 S S S 2 - S - 8 0 2	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 學是 品 仕 検 事	PAGE 1/5			
	BACK	GROUND		(8)			
	1.1	1.1 General 一般専項 1.1 Application 透用範囲 1.2 Operating temperature range 1.3 Storage temperature range 1.4 Test conditions 試験状態 1.4 Test conditions 試験状態 1.5 Test conditions 試験状態 1.6 Test conditions 試験状態 1.7 Test conditions 試験状態 1.8 Test conditions 試験状態 1.9 Test conditions 試験状態 1.1 Test conditions 試験状態 1.2 Operating temperature range 1.3 Storage temperature range 1.4 Test conditions 試験状態 1.5 Test conditions 試験状態 1.6 Test conditions 試験状態 1.6 Test conditions 試験状態 1.7 Test conditions 試験状態 1.8 Test conditions 試験状態 1.9 Test conditions 試験状態 1.1 Test conditions 試験状態 1.2 Operating temperature 選 底: 5~35℃ 1.3 Storage temperature 選 底: 5~35℃ 1.4 Test conditions 試験状態 1.5 Test conditions 試験状態 1.6 Test conditions 試験状態 1.6 Test conditions 試験状態 1.7 Test conditions 試験状態 1.8 Test conditions 試験状態 1.9 Test conditions 試験状態 1.1 Application 透射に表現を表現します。 2. Test conditions に対象に対象を表現します。 2. Test Security・表現状態で行う。 2. Application is applied to low current circuit (Secondary circuit) slide switch used for electronic equipment. 2. Test 表現					
	2.1	Appearance 外親  Construction and dim  ting 定格					
	4. El		E rating 最大定格 6 V DC 0.3 A (Resistive load)(抵抗負荷)	ive load )(松抗负荷)			
		Items 項目	Tost conditions	判定基準			
	4.1	Contact resistance 接触抵抗	Shall be measured at 1 kHz±200 Hz (20 mV MAX, 50 mA MAX) or 1 A, 5 V DC by voltage drop method. 1 kHz±200 Hz、電圧 20 mV 以下、電法 50 mA 以下による方法。 または DC SV, 1A の電圧降下法で到定する。				
	4.2	insulation resistance 格 级 抵 抗	Test voltage: _500_V DC, measured after 1 min ± 5 s	٠.			
	4.3	Yoltage proof 时程圧	Test voltage:				
_[	4.4	Changeover timing 切換タイミング	Refer to individua GIN했品되다. 3 .	l product drawing.			
I	5. He	chanical specification	m. 機械的性能				
ŀ		Items 項目	Test conditions	朝定基坪			
	5.1	Operating force 作 助 力	A static load shall be applied to the root of actuator in operating direction. 提作部の祖元に作動方向へ静荷量を加えて初定する。				
	5.2	Robustness of terminal 始子独成	desired direction for 1 min. The test shall be done once per terminal. damage and breakeg カード は	pa terminal looseness, e of terminal holding may be bent after test. ance requirement speci- il be satisfied. び端子保持部の改領のない の曲がりは差し支えないも 鞍後 4項の電気的性能を装			
	%.5% PAGB			t. 7. 77 Oct 1 51 H. Kamada			

	11400 00 00			<u></u>
5.3	Items 項目 Robustness of actuator 操作節發度	Test conditions 武 聚 条 件  A static load of 20 N (2001 kgf) shall be applied in the operating direction of actuator for 15 s.  操作器の作動方向に 20 N (2001 kgf) の野荷原を15秒間加える。  A static load of 10 N (2001 kgf) shall be applied in the pull direction of actuator for 15 s.	Criteria 料定基準 Shall be free from pronounced wo deformation and mechanical abnormali 著しいガタ及び曲がりのないこと。 また、模域的に展常のないこと。	
		操作部の引張方向に 10 N ( 中央		
5.4	Wobble of actuator 操作部の扱れ	Run-out(P-P) shall be measured by applying a static load of 0.5 N (デザボ) in the perpendicular direction of operation at the tip of actuator. 操作部の先端に作動方向と資角に 0.5 N (51-24) の静存衆を加え、投れ格(最大値)を製定する。	P-P: <u>0.6</u> m W	XX
5.5	Vibration 財 役 性	Switch shall be secured to a testing machine by a normal mounting device and method. Switch shall be measured after following test. スイッチを正規の取付用具、取付方法で試験機に固定し、下記条件で試験を行い、試験後親定する。 (1)Vibration frequency range 振動放範囲: 10~65 Hz (2)Total amplitude 全無報: 1.5 xm (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10-55-10 Hz Approx. 1 min 約1分(4)Method of changing the sweep vibration frequency: logarithmic or linear 持引提動数の変化方法 対数又は直線近似 (5)Direction of vibration: Three perpendicular directions including actuator振動の方向 操作部を含む過速3方向 (6)Duration 延動時間: 2 h each (6 h in total) 各 2時間(計 6時間)	70 ni Insulation resist 100 Mi Voltage proof 配 Apply 50 No dielectr 絶縁配板のが Operating force Vithin spec 規格値内と対	ance 絶縁抵抗(Iten a HK (Iten 4.3): の YAC for 1 min. ic breakdown shall ないこと。作助力 (Iten 5.1): ified value. する。 mochanical almost
5.6	Shock 耐伤罗性	Switch shall be measured after following test. 下記条件で試験を行い、試験後謝定する。 (1)Mounting method 取付方法: Morael mounting method 正規の方法で取り付ける。 (2)Acceleration 加速窓: 450 m/s* (-50-0-)人 (3)Duration 作用時間: 11 ms (4)Test direction 試験方向: 6 directions 6 回 (5)Mumber of shocks 試験回数: 3 times per direction (18 times in total) 各方向各3回(計18回)	70 minusulation resist 100 Minusulation resist 100 Minusulation Minu	ance 絶殺抵抗(Item 4) MIN 電圧 (Item 4.3): ① V AC for I min. ① to breakdown shall ( ないこと。 作動力 (Item 5.1): ifled value. トる。 on rechanical abnor
5.7	Solderability はんだ付け性	Switch shall be checked after following test. 下記条件で試験を行い、試験後的認する。 (1)Solder はんだ:指3A(JIS Z 3282) (2)Flux フラックス: Rosin flux (JIS K 5902) having a nominal composition of 25% solids by mass of water white rosin in 2-propanol (JIS K 8839) solution. ロジン(JIS K 5902)の2-プロバノール(JIS K 8839)溶液とし、遺族は質量比ロジン約25%とする。 (3)Soldering temperature はんだ温度: 230±5 ℃ Immersing time 浸渍時間: 3±0.5 s Flux immersing time shall be 5~10 s in normal rosm temperature. ただし、フラックス浸渍は常温で5~10秒とする。 (4)Immersion depth: Immersion depth shall be at copper plating portion for 予にあ、terminal after nounting. Thickness of P.C.B.: 1.6 mm Immersion depth shall be at wiring portion of lead wire for load wire terminal. ブリント基板用端子はプリント基板(は1.6)突破後、網箔団まで 透液。リード配料用端子は地子のリード積からげ節を浸渍。	covered with sold If frame is made section shall not 没演した部分の 90 いること。	of tin-plate, cut

	KENT No. SSSS2-S-802	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様 奮	PAGE 3/5
		·	
	Itens 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 刺定基準
5.8	Resistance to soldering heat はんだ耐熱性	(3)Temporature and issersing time 芝皮と浸漬時間  Temporature 運政(で) Time 時間(s)  Dip soldering ディップはんだ 250±5 3±1 Once 1回  Nanual soldering 手はんだ 350±10 3 % * Twice 2回  * Second soldering shall be conducted after the switch cooled down.  1回目終了後、一旦常道に戻すことを条件とする。  (4)Izmersion dopth: Immersion dopth shall be at coppor plating portion for 浸渍浸之 P.C.B. terminal after mounting.  Thickness of P.C.B. (Single sided coppor clad phenolic resin P.C.B.):1.2m 1.6 mm  プリント基板用幾子はプリント基板(片面鏡張りフェノール接触積 層板打1.2 t1.6 j实验後、網路固まで浸渍。  (5)Pro-beating condition of dip soldering ・Temporature(At the upside surface of 浸皮・プリント基板のプリヒート条件 コロス・コールを開発 コロス・コールを開発 アンダは人たのプリヒート条件 コロス・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・コールを開発 アンドン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	No abnormalities shall be observed in appearance and operation. The electrical performance requirements specified in item 4 shall be satisfied. Soldering condition of each P.C.board thickness shall be according to paragraph 全のf precaution in use. 外観に著しい変形のないこと。また、動作に異常がなく、4項の電気的性能を 辺足すること。各プリント基板、板厚ごとの半田付条件は、使用上の注象 中頃による。
<u> </u>	<u> </u>	時間	
6.Dur	rability 耐久性能	•	
	ltens 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 刻定基準
6.1	Operating life without load 無食商料命	Switch shall be operated 15,000 cycles at 15~20 cycles/min without load. 無食荷にて15,000サイクル(動作連度15~20サイクル/分)連続動作を行う。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
6.4	Operating life with load 食都好命	Svitch shall be operated at 15~20 cycles/min with condition as following table. 下記表にて(動作速度15~20サイクル/分)連続動作を行う。    Load 食 荷	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
7.Env	vironmental test Eff	•	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1	Cold ES AS 12E	After testing at -40±2℃ for 500h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Mater drops shall be removed40±2℃にて500時間試験後、常温常寝中に1時間放置し1時間以内に初定する。ただし、水海は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Iten 4.1):  100 a A HAX Insulation resistance 起縁抵抗(Iten 4.2): 10 MA MIN Voltage proof 配電圧 (Iten 4.3): Apply 500 V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 起縁破破のないこと。 Operating force 作動力 (Iten 5.1): Within 21 % of specified value. 規格値の 218 X 以内。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、協造に異常がないこと。

	MENT No. 3 S S S 2 - S - 8 O 2	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 無疑 占 仕 核 管	PAGE 4/5
	ltens 項 🗉	Test conditions 試験条件 Criter	a 羽定基準
7.2	Dry hoat 时 熱 性	mormal room temperature and humidity conditions for i h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2℃にて500時間試験後、常温常道中に1時間放置し1時間以内に適定する。 10	
7.3	Dazp heat 財 組 性	stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then neasurement shall be made within 1 h. Mater drops shall be removed.  80±2°C、相対温度90~95%にて500時間が競後、常温常温中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水溶は取り除く。  100 insulation rosis 10	作動力(Item 5.1): 注版 % of specified val 注版 % 以内。 shall be recognised construction.
7.4	Salt mist 塩水噴露	下記条件で試験を行い、試験後確認する。 nixed in netal [	corrosion shall be r art. いさびがないこと。
7.5	Change of temperature 退度サイクル	under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that. Yater drops shall be removed.  下記条件で5サイクル試験後、常道常選中に1時間放歴し1時間以内に到定する。 ただし、水液は取り除く。  85±2℃  No dielect 結果物域の Operating force Within 1 h after that. Yater drops shall be removed.  Insulation resistant process of the proce	作動力(Item 5.1): \$8 % of specified val ±18 % 以序。 shall be recognized construction.
7.6	Damp heat with load (Resistance to silver migration) 財 退 負 荷 (耐磁マイク・レーション 特性)	tween adjacent terminals at 60±2°C and 90~95%RH. After 500 h testing, switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that.  Apply 100V	AC for 1 min. Fic breakdown shall oc 子面印加。

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
95992-\$-802	1	製品仕様符	5/6
ì			

【Proceution in use】 ご使用上の注意

1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 増子をはんだ付けされる場合、塊子に荷重が加わりますと条件によりがタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。

2. Use of water-soluble soldering flux shall be evoided bacause it may cause correction of the switch はんだ付けの際、水溶性フラックスはスイッチを皮含させるおそれがありますのでご使用はお取け下さい。

3, Excessive operating force over specified value shall be avoided to the actuator because it is small and west

操作部は小さいため強度が弱くなっておりますので、操作部に規格値以上の力が加わらないようにご配慮下さい。

4. Designing printed pattern and parts layout shall be considered because the characteristics may change due to warp of P.C.B. **基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮駆います。** 

5. When soldering alide should be at the P position in product drawing

はんだ付けの際、スライドのつまみを製品図と同位便に移動させてはんだ付け下さい。

6. Unstable contact may occur if the switch is used lower than DC IV or 10  $\mu$  A. Piezze consult us for special applications

電圧DC1V以下または電流10μA以下で使用しますと、接触不安定となることがあります。このような用途に使用される場合は別途ご相談下さい。

7. This switch is designed and manufactured to be used for general electronic equipment such as audio-visual equipment, home electronica, informatic and communication related equipment. If you intend to use the switch for sophisticated equipment requiring more safety and reliability, such as life support, space and aviation, disaster prevention or security related equipment, please feel free to contact us about sultability. 本製品はオーディ接種。映像複雑。家電機器。情報機器。透像機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置。 宇宙・航空機器。 防災・防犯機器

などの高度の安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご相談下さい 8. In case of storing this switch for a long period (longer than six months after delivery), it must be sealed in a plastic bag and stored in a cool and dark place in order to prevent the solderability of the terminal surface from deteriorating due to film to be formed on it.

長期保管の場合(納入後6ヶ月程度以上)は、 蝸子表面の皮膜形成によるはんだ付け性の劣化等を防ぐため、 製品をビニル装等で密封し、 直射日光の当たらない冷暗所 に保管して下さい。

. The soldering condition of cories SSSS2 shall be as follows. The deformation or defects in electrical performance might be occurred if time or

temperature exceed this specification SSSS2の半田条件は、下記の仕様でお願いします。時間又は湿度が当規格よりオーバーされますと変形及び電気的特性劣化の恐れがありますのでご注意ください。

## ①Dlp soldering ディップの場合

・Temperature 退度 260±5℃ ・Time 時間 3±1 s

・Thickness of P.C.board プリント基板厚(mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.8

·Pro-heating condition プリヒート条件

Temperature(At the upside surface of P.C.B) 遠度(ブリント美板の上面) : 110°C MAX

Time 時間: 90 s

②Manual soldering 手半田の場合

(s MAX)

Temperature of soldering iron tip こて先退度(*C)	260±10	300±10	350±10
Thickness of P.C.board プリント基板厚(mm)			
0.8	5	6	3
1.0	5	5	3
1.2	5	5	4
16	5	5	4

\* Abnormal pressure shall not be applied to the terminal.

但し、幾子に異常加圧のないこと。

Notes 注) (1) P.C.board shall be single sided copper clad P.W.B.

ブリント基板については、片側網張フェノール樹脂積層板とする。

(2) This test shall be performed up to twice. After first test, temperature shall be back to normal. 本試験は2回までとし、1回目試験後は一旦常選に戻すこととする。

